

# 【事例】 CT撮影による 20層基板銅箔パターン分離

2020年4月17日  
株式会社 ビームセンス

# 1. 条 件

## ■ 撮影サンプル

- 20層2.8mm厚プリント基板

## ■ 撮影および断層像

1. CT撮影：FLEX-MH867

4CCD結合、幾何拡大率 =  $\times 4.7$ 、1.08度ピッチ  $\times 337$ 回 撮影

2. 3次元画像再構成処理：BSC Tソフト

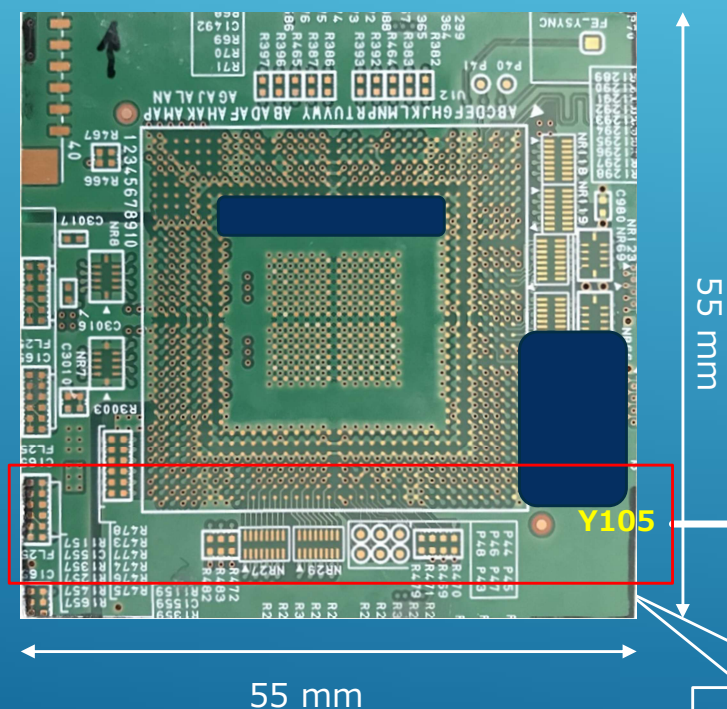
再構成分解能 ( $20\mu\text{m}/\text{pixel}$ )

3. スライス方向：Z軸方向、XZスライス

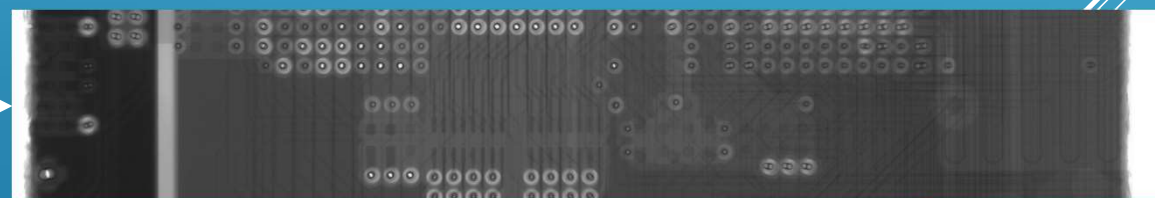
# ■ サンプル外観と透過X線画像

【外観】

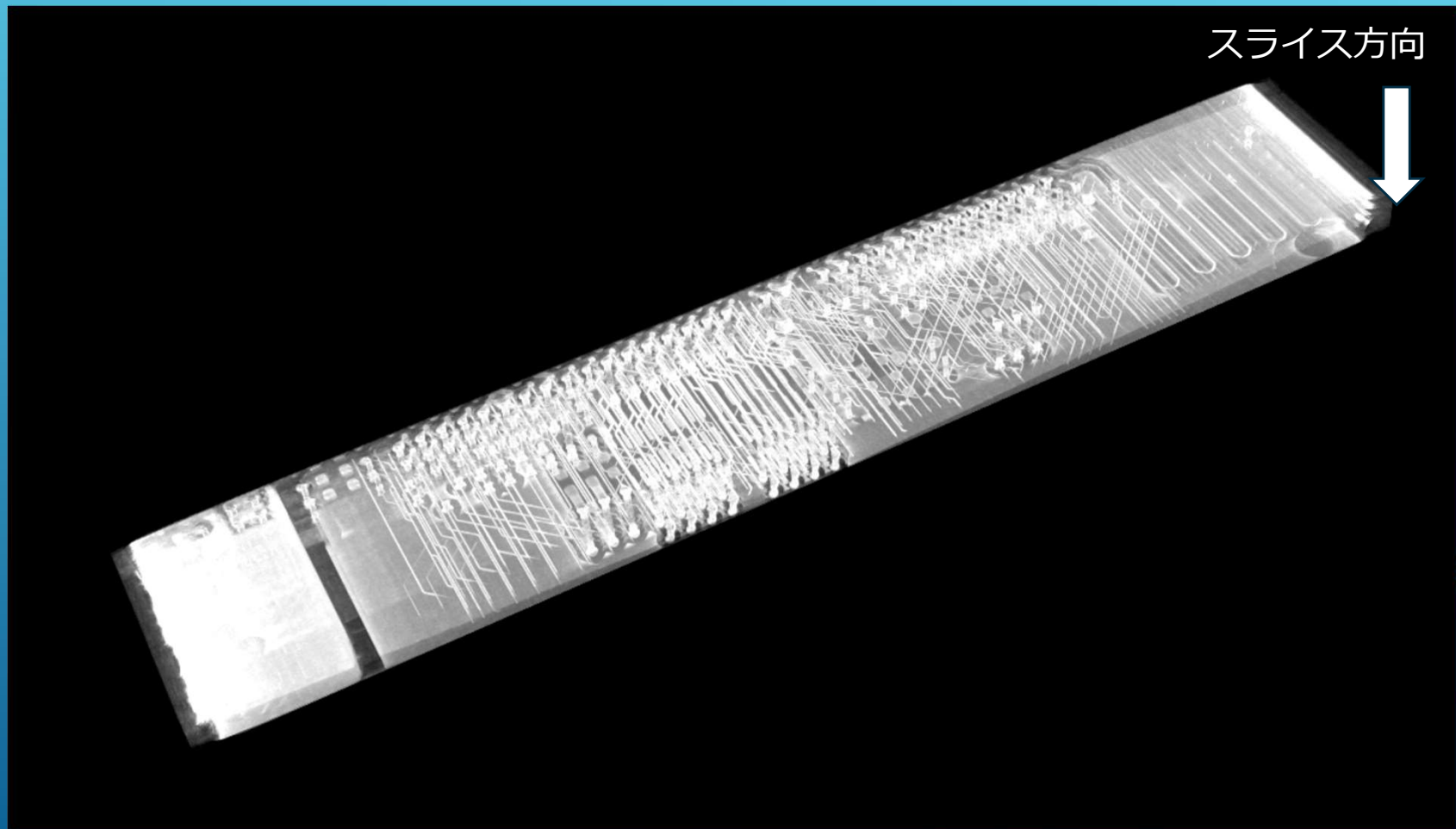
【透過X線画像】



撮影範囲



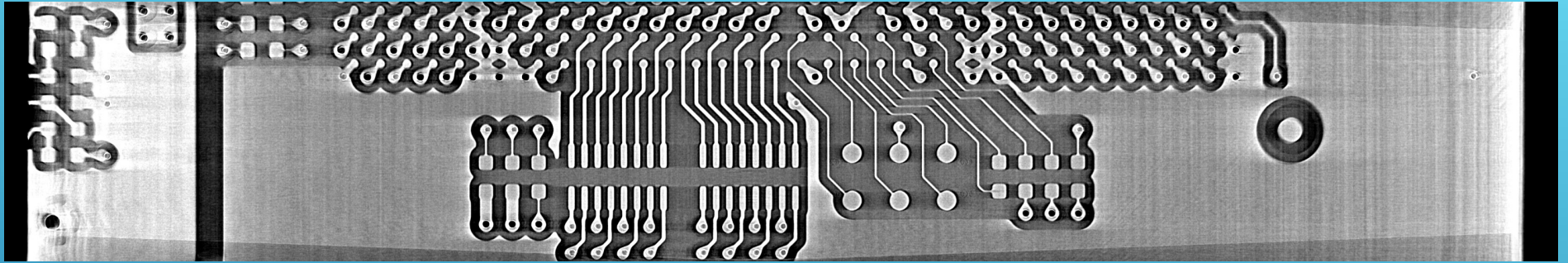
## ■ 3D X線画像



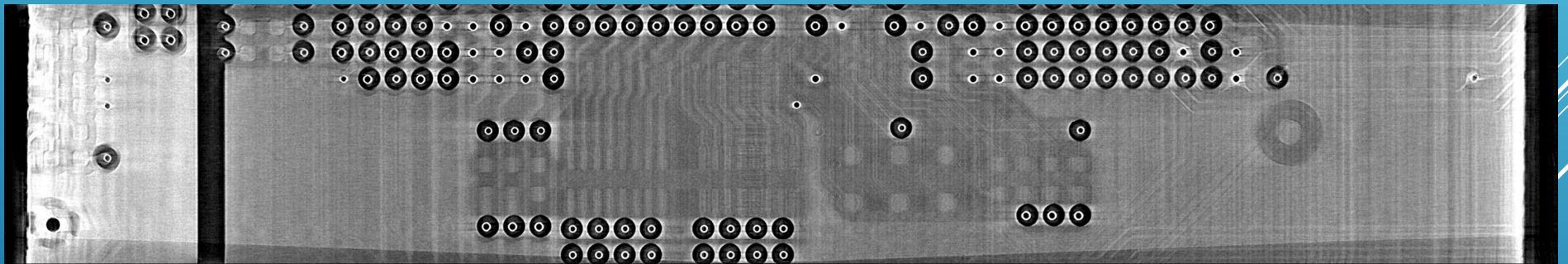


## ■ スライス画像 Y105

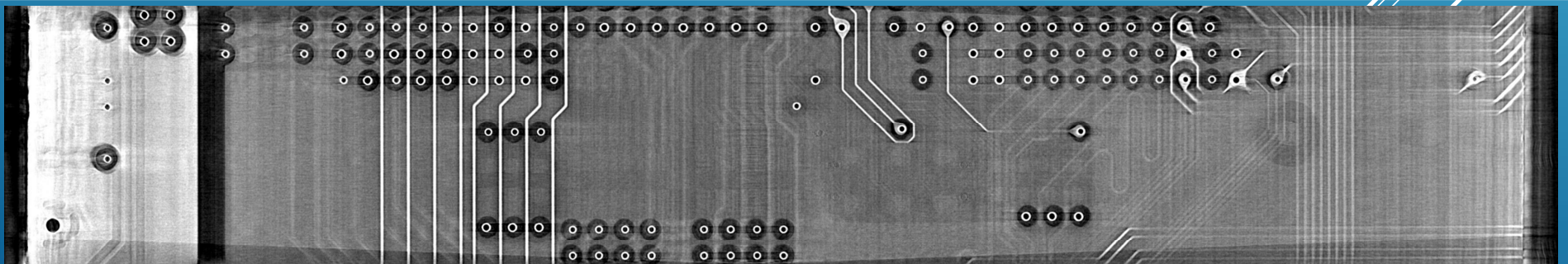
1 層



2 層



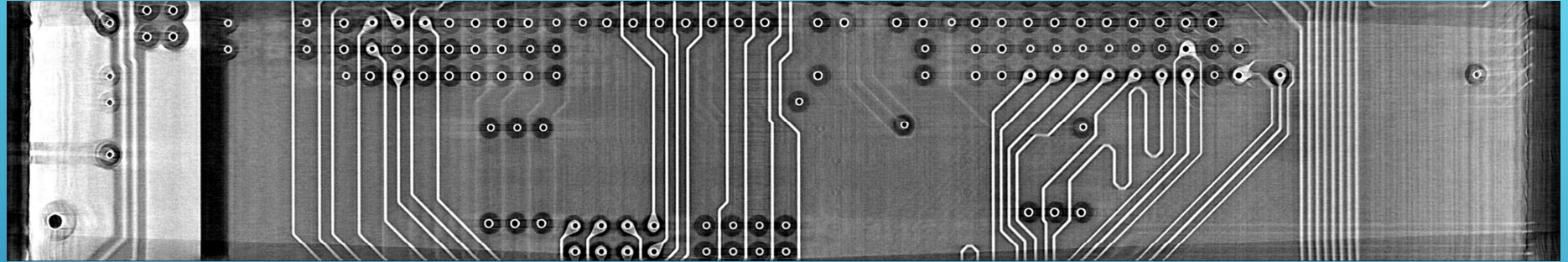
3 層



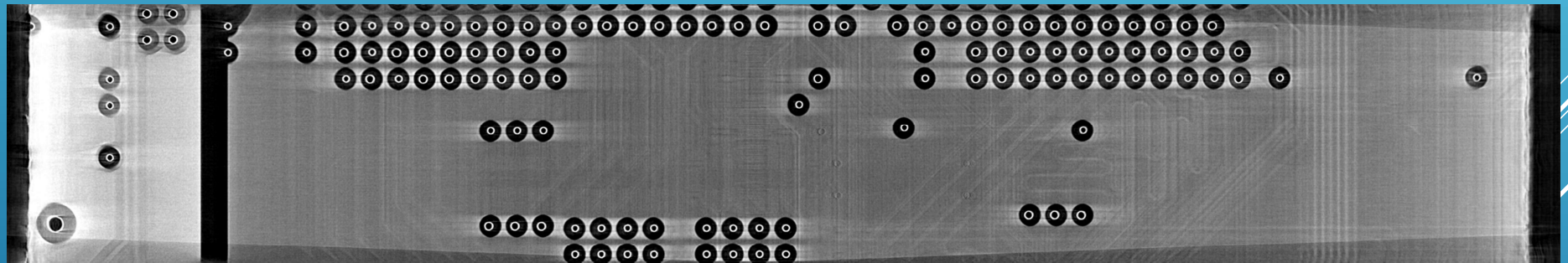


## ■ スライス画像 Y105

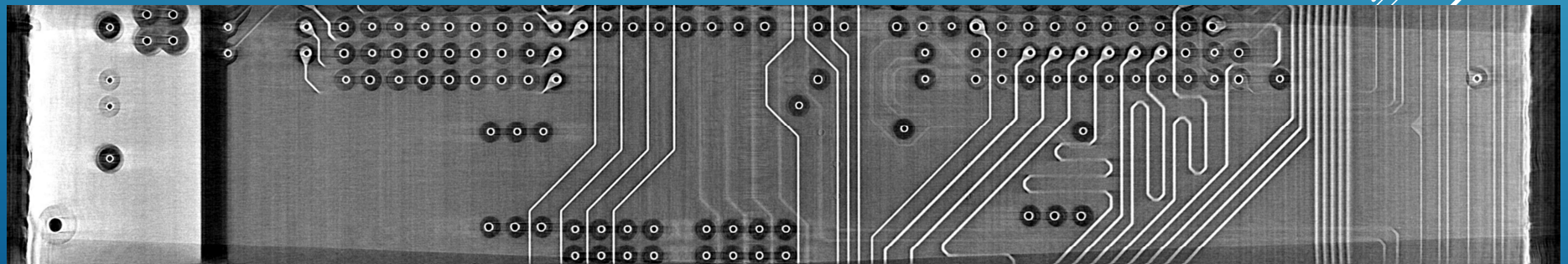
4層



5層



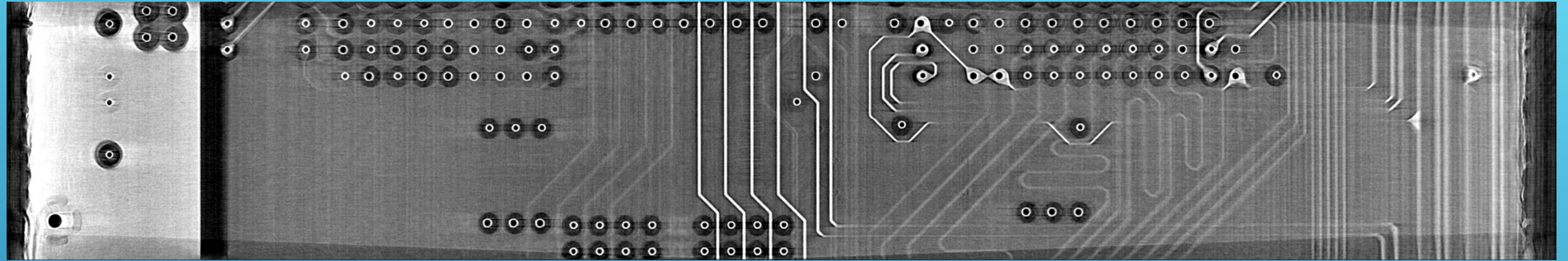
6層



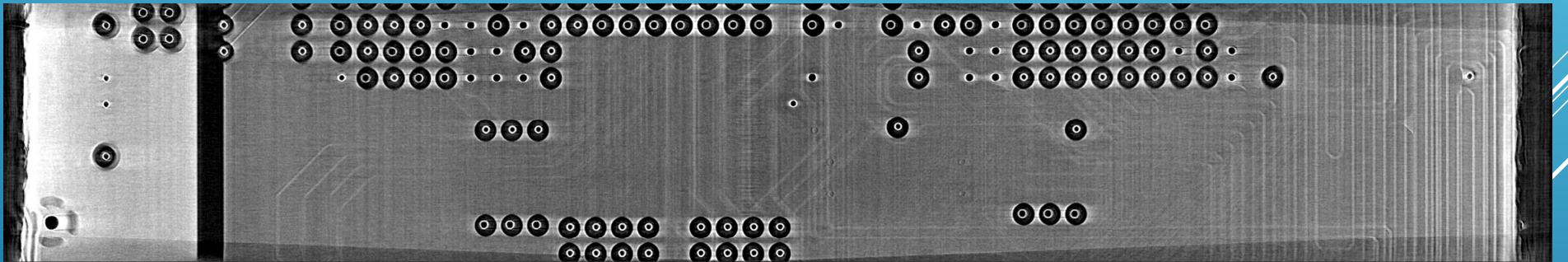


## ■ スライス画像 Y105

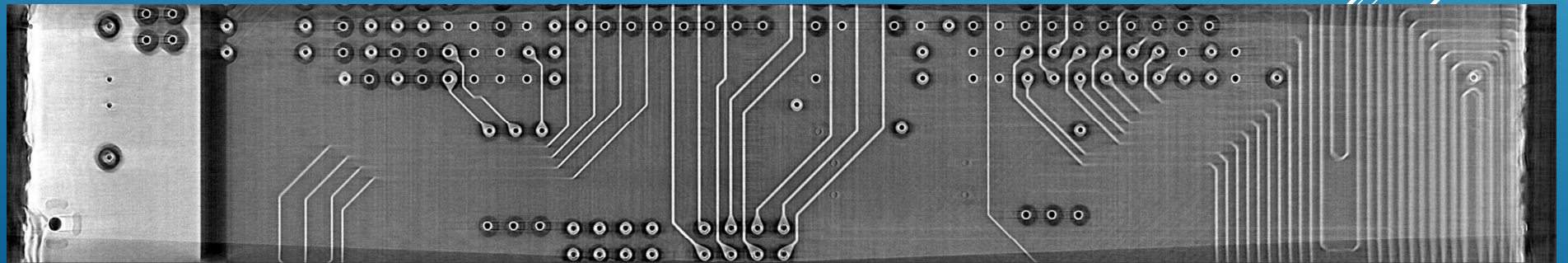
7層



8層



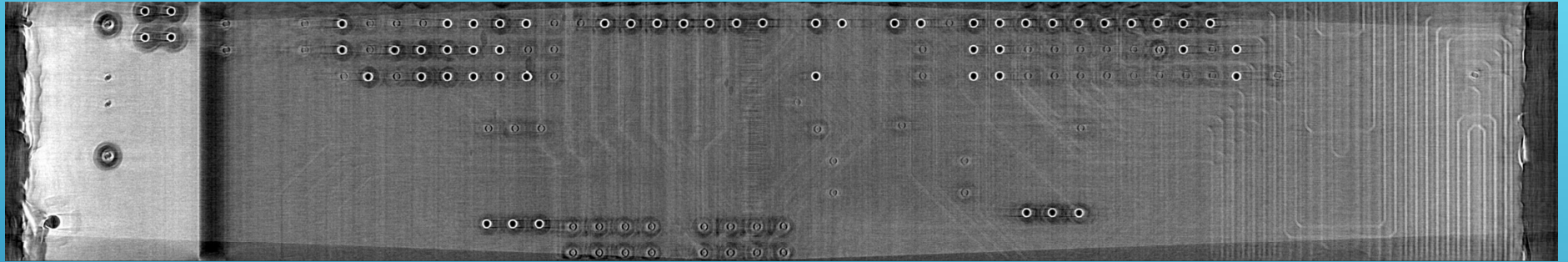
9層



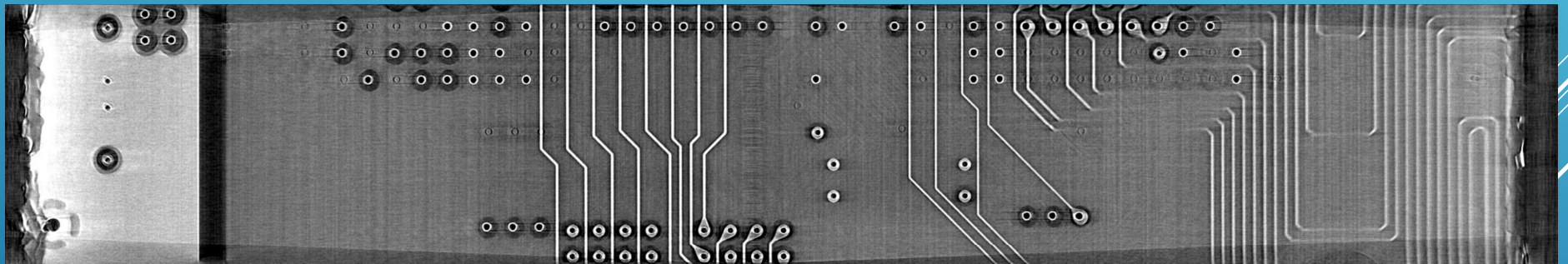


## ■ スライス画像 Y105

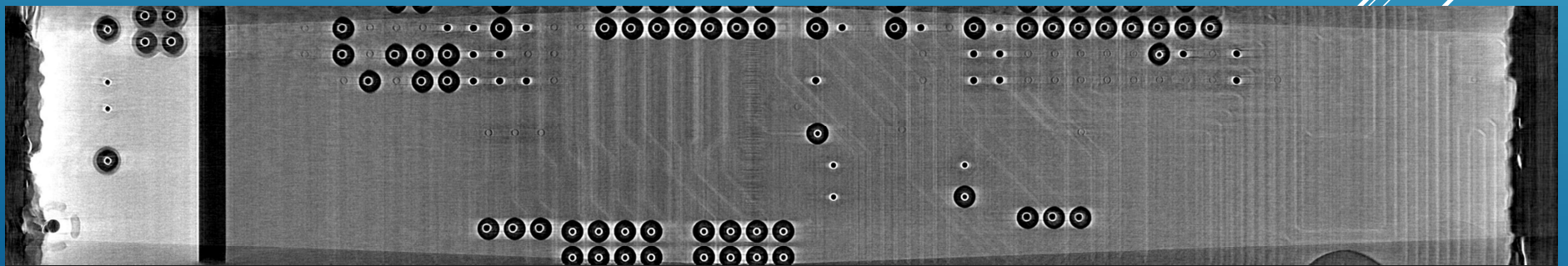
1 0 層



1 1 層



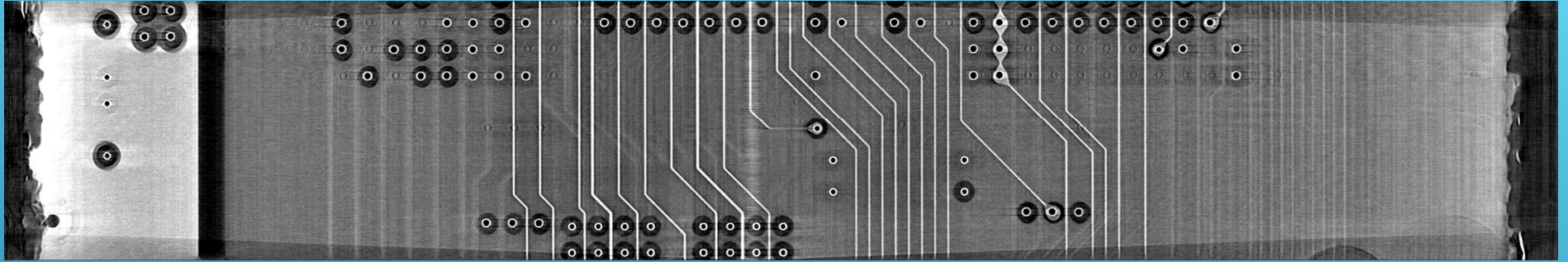
1 2 層



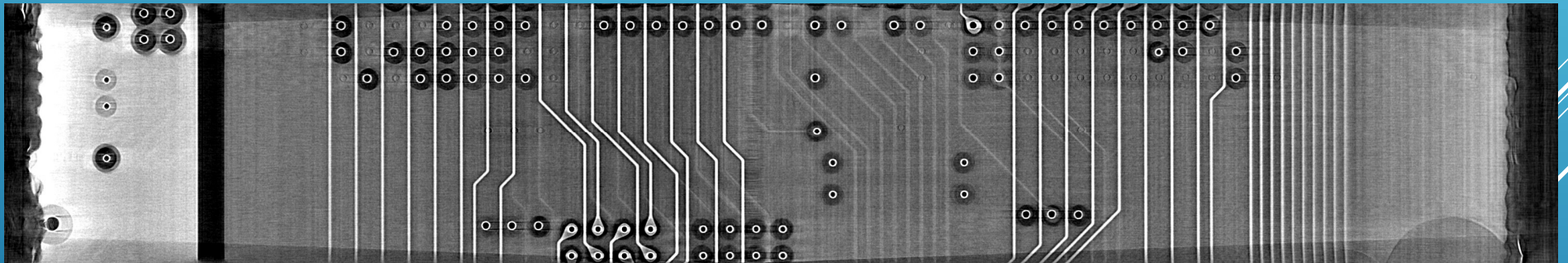


## ■ スライス画像 Y105

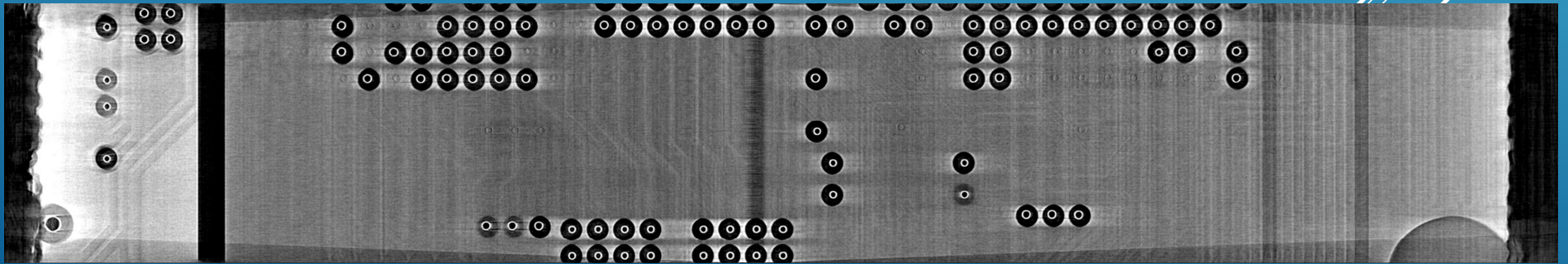
1 3 層



1 4 層

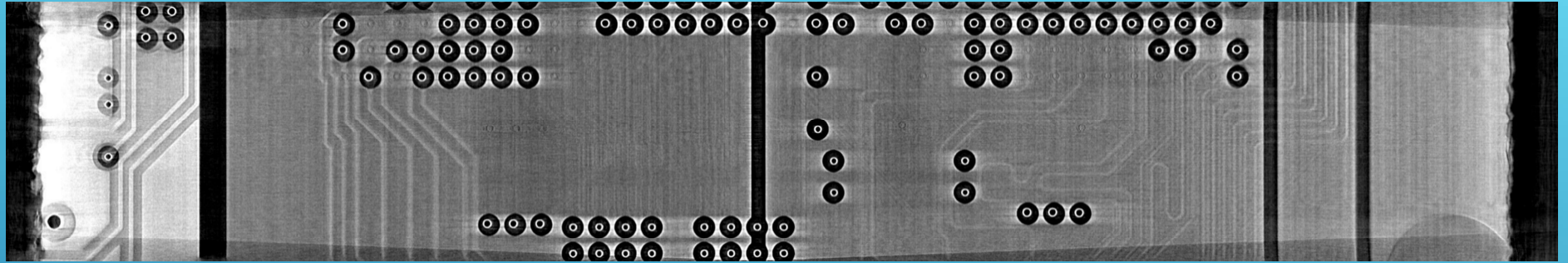


1 5 層

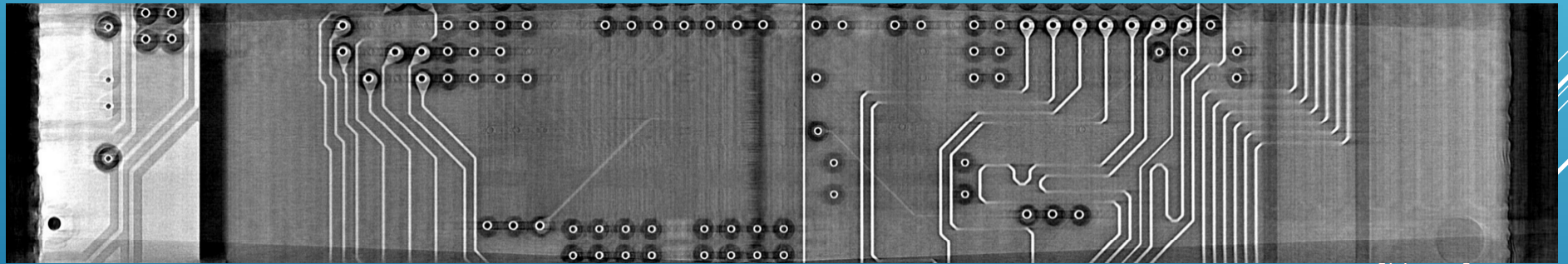


## ■ スライス画像 Y105

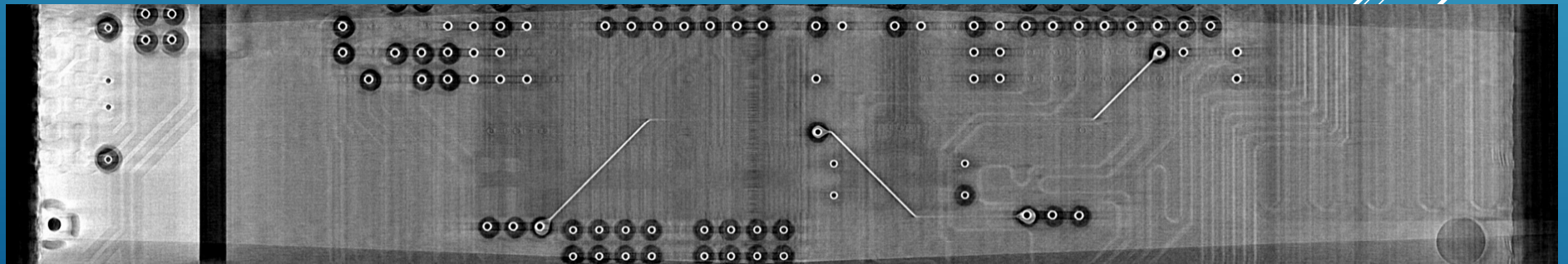
1 6層



1 7層



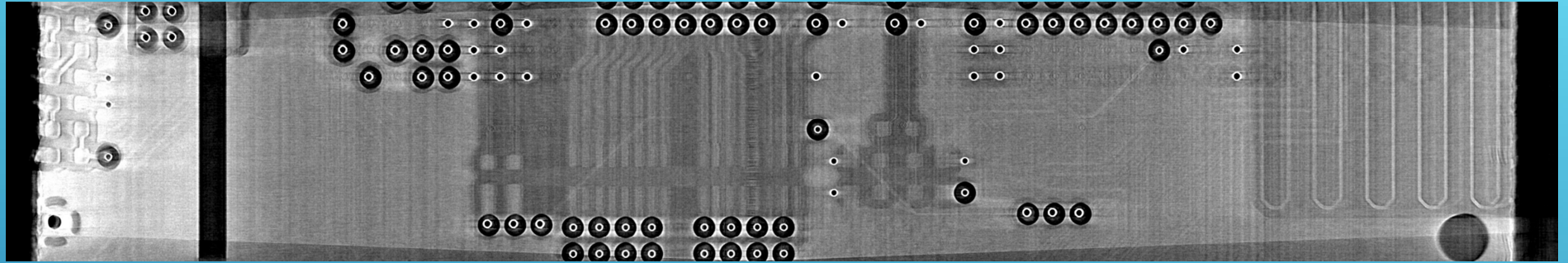
1 8層



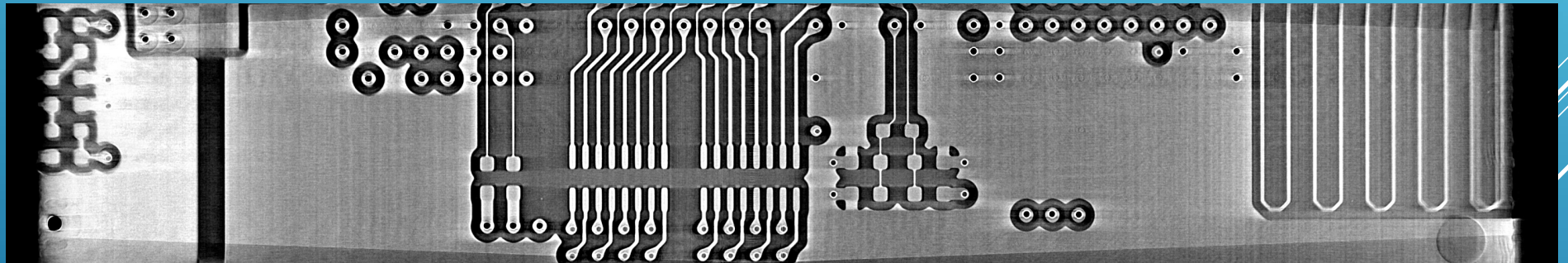


## ■ スライス画像 Y105

19層



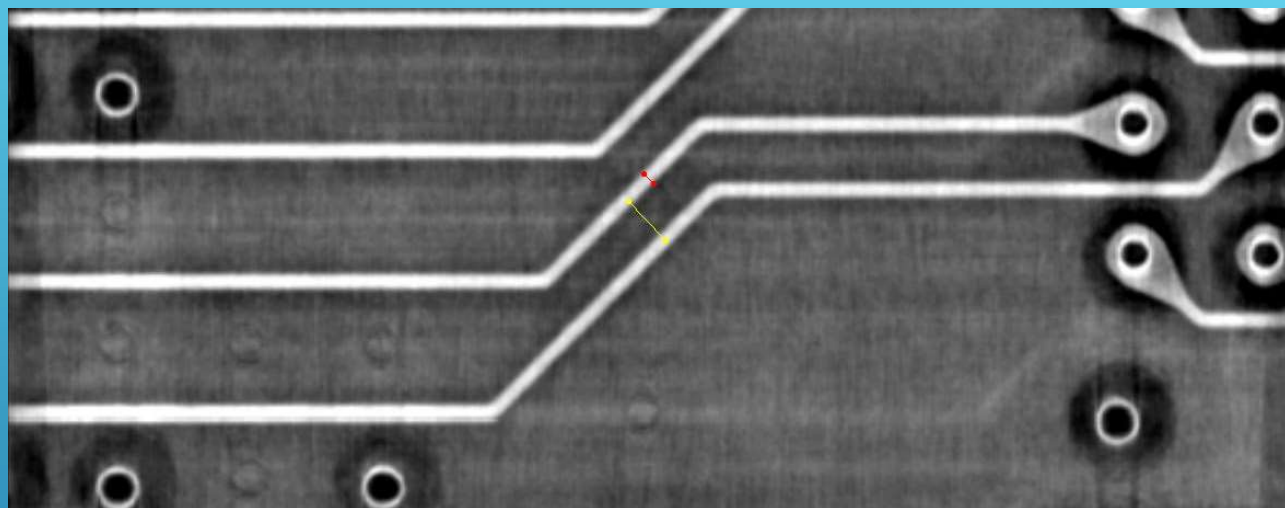
20層



## ■ 計測

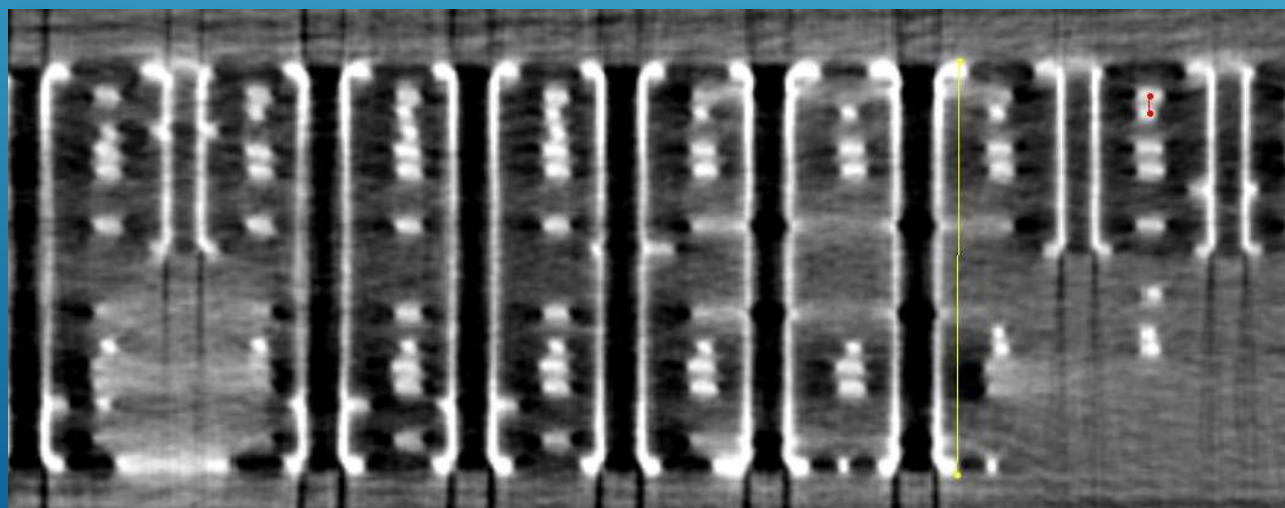
◆ 14層

Line = 108  $\mu\text{m}$   
Space = 420  $\mu\text{m}$

[illegible]

## ◆断面

層間 = 114  $\mu\text{m}$   
基板厚 = 2,834  $\mu\text{m}$



**計測**

距離    角度    面積    体積

Name	Solution( $\mu\text{m}$ )
<input checked="" type="checkbox"/> A-B	114.283
<input checked="" type="checkbox"/> C-D	2934.316

追加      削除

キャンセル      保存



【お問い合わせ先】

株式会社 ビームセンス

BEAMSENSE CO.,LTD.

〒564-0041 大阪府吹田市泉町2-19-16

2-19-16 Izumi-cho , Suita City , Osaka 564-0041,Japan

info@beamsense.co.jp